

NEWS ANNOUNCEMENT

FOR IMMEDIATE RELEASE

* 2016 年 5 月 17 日に発表されたプレスリリースの抄訳です

タワージャズ、IoT の課題に応える SiGe ベースの新しい統合型 RF プラットフォーム

「シングルチップ フロントエンドモジュール」の量産を開始

単一チップ上にパワーアンプ、低ノイズアンプ、スイッチの統合が可能に

**タワージャズ、2016 年 5 月 22 日～27 日に米カリフォルニア州サンフランシスコで開催される
国際マイクロ波シンポジウム (IMS) に出展**

ミグダルハエメク(イスラエル)、ニューポートビーチ(米カリフォルニア州)2016 年 5 月 17 日ー グローバルスペシャルティファン
ドリーダーの**タワージャズ**は本日、IoT アプリケーションの課題に応えることに特化し、単一チップ上に無線フロントエンドモジ
ュール (FEM)を統合することが可能な新しい RF 技術の量産を発表しました。アナリストによると、インターネットに接続され
た IoT デバイスの数は年 15~20%で成長し、2020 年までに 300 億台に達すると見られています。マッキンゼー・グローバ
ル・インスティテュートは最近、IoT は 2025 年までに世界で最高 11 兆ドルの価値を生み出すと予想しました。

タワージャズのこのプロセスにより、パワーアンプ (PA)、スイッチ、低ノイズアンプ、CMOS デジタルおよびパワーコントロールを
ひとつのチップに統合することが可能になります。タワージャズは現在この製品をスマートフォン、タブレット、ウェアラブル端末
向けに提供しています。また、競合するソリューションに対して、コスト、消費電力、性能、フォームファクタのメリットを提供す
ることにより、IoT アプリケーションに求められる、さらに普遍的な要件も満たしています。

例えば、タワージャズは、この技術を用いた初の統合型無線 FEM の提供に向けて、人、モノ、場所をつなぐ高性能アナロ
グ半導体の革新的な業界リーダーである Skyworks Solutions, Inc.と協力しています。Skyworks 社のコネクティビティ ソリ
ューション担当ゼネラルマネージャー/バイスプレジデントである Bill Vaillancourt 氏は次のように述べています。「PA ベース
製品向け SiGe BiCMOS に関して、タワージャズと当社による長いパートナーシップが今日 Skyworks Solutions の主要な
お客様向けに量産段階に入ることを嬉しく思います」

タワージャズの新しい RF 技術には、シリコンベースでクラス最高の性能を備えた 0.18um SiGe PA デバイス、低 Ron-Coff
スイッチデバイス、SiGe 低ノイズアンプ、パワーコントロール向け 5V CMOS、MIPI またはその他のデジタルコンテンツを統合
する 0.18um CMOS、ならびに低損失インダクタやマッチングコンポーネントのための厚膜銅配線層が含まれます。無線フロ
ントエンドモジュールに通常求められるアクティブ部品をすべて提供することで、この技術は、今日の IoT を形成している複

数の通信規格 (WiFi、Bluetooth、802.15.4、NFC) を同一チップ上に統合できる新しい製品ファミリーを実現することができます。

タワージャズの RF/高性能アナログおよび米国航空宇宙・防衛ビジネスグループ担当シニアバイスプレジデント・ゼネラルマネージャー兼ニューポートビーチ サイトマネージャーである Marco Racanelli 氏は次のように述べています。「この新技術は、当社がすでに有している SiGe PA および RF SOI スイッチ技術を補完するもので、クラス最高のシリコンベースの PA 性能を提供すると同時に単一チップ上にこれらの要素を組み合わせることが可能となり、アーキテクチャ上の新しい選択肢をお客様に提供できるようになります。

タワージャズは、RF およびマイクロ波業界の展示会である IMS (国際マイクロ波シンポジウム) 2016 において、スペシャルティ IC 製造のための当社の先進的なプロセステクノロジーを展示します (ブースNo. 1532)。タワージャズの [RF および高性能アナログ技術](#)に関する詳細は、当社のウェブサイトをご覧ください。

タワージャズについて

タワーセミコンダクター株式会社 (NASDAQ: TSEM, TASE:TSEM)は、米国にある完全子会社ジャズセミコンダクター社とタワージャズテキサス社とともに、タワージャズというブランド名でグローバルに事業展開するスペシャルティファンドリのリーダーです。タワージャズは、集積回路を生産し、SiGe、BiCMOS、ミックスドシグナル/CMOS、RF CMOS、CMOS イメージセンサ、パワーマネジメント(BCD および 700V)、MEMS など、カスタマイズが可能なプロセス技術を幅広く提供しています。また迅速かつ正確なデザインサイクルを実現する世界クラスのデザインイネーブルメントプラットフォームを提供し、IDM やキャパシティ拡大を必要とするファブレス企業向けには Transfer Optimization and development Process Services(TOPS)を提供しています。詳細は www.towerjazz.com をご覧ください。

複数のファブを使ってサービスを提供するために、タワージャズはイスラエルに 2 か所(150mm と 200mm)、米国に 2 か所(200mm)のファブに加え、タワージャズが過半数の株式を保有するパナソニック社と設立したパナソニック・タワージャズセミコンダクター社(TPSCo)の日本の 3 拠点(200mm と 300mm)のファブと連携しています。TPSCo を通じて、タワージャズは、最先端のイメージセンサ技術を含む、先端の 45nm CMOS、65nm RF CMOS および 65nm 1.12um ピクセル技術の提供が可能となります。詳細は www.towerjazz.com または www.tpsemico.com をご覧ください。

TowerJazz Company Contact: Lauri Julian | +1 949-280-5602 | lauri.julian@towerjazz.com

TowerJazz Investor Relations Contact: Noit Levi | +972-4-604-7066 | noit.levi@towerjazz.com